

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

宁波江丰电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位	东方阿尔法基金、诺安基金、人保资产、东方红基金、聚享智研、天风证券 6 家投资机构。
时间	2023 年 6 月 12 日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书兼投资总监蒋云霞
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>投资者参观了公司的产品展厅，并在公司会议室与董事会秘书进行问答交流，交流内容如下：</p> <p>1、公司通过控股子公司生产覆铜陶瓷基板，公司是出于什么考虑去拓展这块业务，有技术的相通性吗？</p> <p>回复：第三代半导体材料是公司持续关注的一个领域，近年来，随着半导体产业链国产替代加速，且新能源汽车、</p>

轨道交通、特高压、5G 通讯、绿色电力等新兴领域高速发展，市场对功率半导体芯片核心散热基板的需求快速提升。覆铜陶瓷基板具备良好的导热性能、电气性能和绝缘性能，可以解决芯片的散热问题，提升散热效率、满足高功率需求。在技术方面，公司能够对产品做到较好的品质管控，保证批量生产的品质一致性和稳定性。同时公司还建立了专业的技术团队，将持续致力于第三代半导体的材料国产化工作。

2、陶瓷基板的生产工艺、市场前景如何？

回复：目前，陶瓷基板采用两种主流的生产工艺，即 DBC（Direct Copper Bond 的简称）直接覆铜工艺和 AMB（Active Metal Bonding 的简称）活性金属钎焊工艺。其中 AMB 基板结合强度更高，其耐高低温冲击失效能力更强，随着高铁、新能源汽车、光伏等领域对于电压等级的要求逐步提升，AMB 基板已经成为第三代半导体和新型大功率电力电子器件 IGBT 的首选模组化材料。目前，全球 AMB 基板制造企业不多，以海外供应商为主。

公司控股子公司宁波江丰同芯半导体材料有限公司已经掌握覆铜陶瓷基板 DBC 及 AMB 生产工艺，主要产品为高端覆铜陶瓷基板，相关产品已初步获得市场认可，未来发展目标是实现对第三代半导体用覆铜陶瓷基板的国产替代。

3、公司铜靶材的进展情况如何？

回复：超高纯铜及铜锰、铜铝合金靶材是目前使用最为广泛的先端半导体导电层薄膜材料之一。公司超高纯铜及铜锰、铜铝合金靶材在多家客户的认证评价顺利，业务积极有序推进。公司的超高纯铜及铜锰、铜铝合金靶材未来还有很大的成长空间，公司将凭借研发创新能力、品质管理能力和客户服务能力，努力提升产品竞争力和市场份额。

	<p>4、半导体靶材的制造壁垒主要体现在哪方面？</p> <p>回复：公司溅射靶材产品的技术难度主要体现在高纯金属纯度控制及提纯技术、晶粒晶向控制技术、异种金属大面积焊接技术、金属的精密加工及特殊处理技术、靶材的清洗包装技术等方面。</p> <p>经过多年发展，公司已经掌握了半导体靶材生产制造的核心技术，积累了丰富的产业经验，并建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在生产经营的各个环节均实施了较为完备的质量检测程序，以此确保产品的品质和可靠性。</p> <p>同时，公司持续推进超高纯金属原材料和生产装备的国产化，通过商业合伙、股权投资等方式建立了国内稳定安全的供应链体系，还自主设计了一大批高精尖的生产装备，不断增强公司的硬核实力。</p> <p>5、公司的半导体零部件主要应用在哪些领域和设备？</p> <p>回复：公司生产的半导体零部件主要用于半导体设备制造和半导体芯片制造领域，产品可分为工艺消耗零部件和设备制造零部件，覆盖了包括 PVD、CVD、刻蚀、离子注入等半导体设备。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 6 月 12 日